

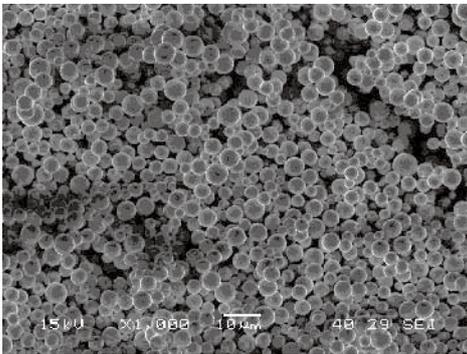
鉛フリー対応 Lead Free

超ファインピッチ対応ソルダーペースト

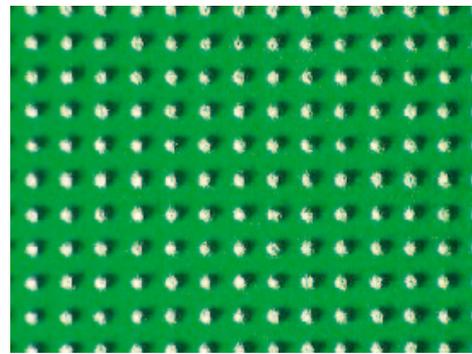
Solder Paste for Fine Pitch

LFSOLDER LF-204-15

ファインピッチ用に最適!
For Ultra-fine Pitch Solder Bump Forming



はんだ粉末SEM写真
SEM photograph of solder powder



印刷抜け性(70 $\mu\text{m}\phi$)
Printability (70 $\mu\text{m}\phi$)

特長

- 70 $\mu\text{m}\phi$ の微細なパターンにおいても、版抜け性が良好です。
- リフロー後の残さは、準水系洗浄剤により洗浄が可能です。
- 既存の設備を使用して、はんだバンプの形成が可能です。

FEATURES

- An excellent printing shape even in the case of fine patterns of 70 $\mu\text{m}\phi$.
- Possible to clean flux residues after reflow by quasi water-soluble detergents.
- Possible to form solder bumps by any existing equipment.

一般特性 General Properties

項目	ITEM	LF-204-15
合金組成	Alloy Composition	Sn / 3.0Ag / 0.5Cu
融点	Melting Point (°C)	216~220
はんだ粉末の粒度	Particle Size of Solder Powder (μm)	1~12
フラックス含有量	Flux Content (%)	12.0
塩素含有量	Chlorine Content (%)	0.0
粘度	Viscosity (Pa·s)	260
チクソトロピー指数	Thixotropy Index	0.65



問い合わせ先

株式会社タムラ製作所 電子機材営業部

〒358-8501 埼玉県入間市狭山ヶ原16-2 TEL 04 (2934) 6131 FAX 04 (2934) 6559